



DISCO

# 株式会社ディスコ

## ワークシップ型インターンシップ

半導体切断装置の世界シェアNo.1企業で  
あなたに本当に合った仕事を見つけましょう!!



本社R&Dセンターは大田区大森  
昨年11月には新棟も完成。

### みなさん、ディスコを知っていますか？

ディスコは皆さんの身の回りにある半導体や電子部品の製造に  
欠かせない半導体切断装置メーカーです。

創業1937年以来、「Kiru(切る)・Kezuru(削る)・Migaku(磨く)」を  
追求し続け、変化の激しい半導体業界で、更なる技術進化に  
よる快適な社会の実現を目指し続けた結果、半導体切断装置  
において世界シェア70%を頂いております。

ディスコは装置開発、ソフト、電気、アプリケーション開発、製造  
をはじめ、国内営業、海外営業、や管理系(総務・人事・経理・広  
報など)多岐に渡る職種で構成されています。

就職活動を始めるファーストステップとして、ディスコのインター  
ンシップで、あなたに本当に合った仕事を見つけましょう!

皆さんにお会いできることを、楽しみにしております。

1. 対象者 大学3年生および大学院修士1年生
2. 実施スケジュール 2009年8月10日(月)~12日(水)、17日(月)~19日(水)
3. 内容 ワークショップ型インターンシップ ※詳細は説明会でお話します!
4. 就業時間 7.75時間/1日 ※カリキュラムの内容により変更があります
5. 待遇 インターンシップ期間中は、当社負担の傷害保険に加入いたします。
6. 応募方法 当社HPに掲載のエントリーフォームよりご応募ください!!

HPのURL: <http://www.disco.co.jp/jinzai/index.html>

応募期間: 2009年6月8日(月)~6月30日(火)